

(遠距) 雷射在半導體產業應用技術 種子師資培訓班

■ 課程簡介：

在經濟部產業專業人才發展推動計畫指導下，為協助推動技專校院人才發展計畫，培育人才，盼藉由雷射在半導體產業應用技術種子師資培訓班，邀請對雷射技術議題有研究的老師，藉由課程了解雷射加工技術與應用實例，快速了解雷射產業，並將雷射原理及整合應用之各專業概念作分析與專業課程內容介紹，期能有助於教師從培訓課程的設計及經驗，導入業界人才需求之課程，以提升學生實務之教學品質。

課程大綱：

111年9月29日 (四)		
時間	課程大綱	講師
09:30-12:30	一、雷射加工技術應用於先進封裝製程 1.雷射原理與加工系統簡介 2.雷射鑽孔在先進封裝製程應用 3.雷射切割應用於半導體製程 4.雷射曝光技術與系統簡介	陳育斌 副總經理 東台精機股份有限公司 電子設備事業處
12:30-13:30	午餐	
13:30-16:30	二、雷射表面處理應用技術與實例 1.雷射表面微加工技術與實例 2.雷射表面熔覆技術與實例 3.雷射表面改質技術與實例	陳天青 總經理 精鐳光電科技股份有限公司
111年9月30日 (五)		
時間	課程名稱及大綱	講師
09:30-12:30	三、雷射精密切割玻璃基板技術 1.雷射應用範圍 2.玻璃基板切割方法 3.雷射切割玻璃技術與裝置 4.雷射安全	曾釋鋒 副教授 國立臺北科技大學 機械工程系
12:30-13:30	休息	
13:30-16:30	四、雷射加工技術於光電半導體薄膜製程應用 1.雷射製程設備再製造領域機會與市場 2.雷射於光電與半導體材料應用 3.個案分析介紹	蕭文澤 博士 財團法人國家實驗研究院 台灣儀器科技研究中心 生醫與曝光機系統組

※主辦單位得因不可抗拒因素，保留本培訓班內容及講師異動之權利。

【 開 課 資 訊 】

- 主辦單位：財團法人工業技術研究院
- 承辦單位：社團法人台灣電子設備協會
- 舉辦地點：線上課程
- 舉辦日期：111年9月29-30日(四五)09:30-16:30 (兩天共12小時)
- 課程費用：免費，限大專院校相關系所教師報名，不含教職員及學生。
- 報名方式：
 - 1.網路報名：<https://www.teeia.org.tw/zh-tw/Course/1110929-30/155>
 - 2.請於報名後，提供教師證或名片影本 e-mail 至 vivi@teeia.org.tw，以利確認查核。
 - 3.2日課程皆需出席，結業時將發給教師種子師資培育時數證明。
- 報名聯絡人：

TEL：02-27293933 ext.17 楊小姐, ext.22 鄭小姐

FAX：02-27293950

E-mail：vivi@teeia.org.tw、anne@teeia.org.tw
- 注意事項：
 1. 完成線上報名後，系統會發送『報名通知信』至您的 email 信箱，如未收到請來電確認。
 2. 為尊重講師之智慧財產權益，恕無法提供課程講義電子檔。
 3. 為配合講師時間或臨時突發事件，主辦單位有調整日期或更換講師之權利。
 4. 因課前教材、講義準備，若您不克前來，請於開課三日前告知，以利行政作業進行並共同愛護資源。
- 主辦單位保留報名資格之最後審核權利。

掃我報名

